

TB185 v2

PanelPC 18.5" • INTEL Elkhart Lake • Encastrable et VESA

Processeur INTEL Elkhart Lake J6412

PanelPC 18.5" • Résolution 1366 x 768 (Option FullHD)

Dalle tactile P-CAP multipoints (résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

1 RS232 • 3 USB 3 • 3 USB 2

2 ports Ethernet INTEL I225 (2.5 GbE)

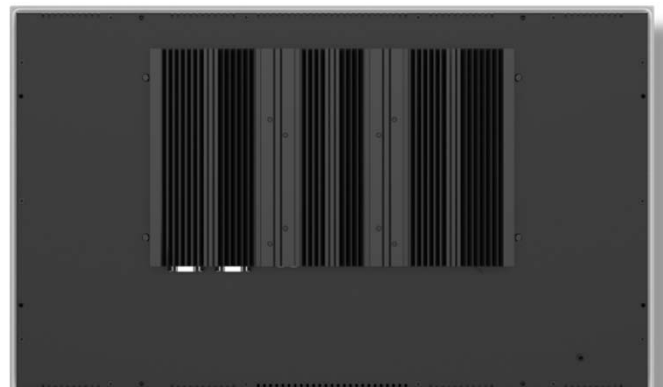
Alimentation 12V DC / 220 AC (option 12~24V DC)

Comptabilité Windows 11



| Système | |
|-------------------|---|
| Chipset | INTEL Elkhart Lake |
| Processeur | INTEL J6412 |
| Proc. Vidéo | INTEL UHD Gen 10 |
| Dalle LCD | 18.5" • Résolution 1366 x 768 • 500 nits (Dalle FullHD 1920x1080 en option) |
| Dalle Tactile | Dalle capacitive PCAP 10 points (Dalle résistive en option) |
| Mémoire | 32GB SODIMM DDR4 max |
| Stockage | M.2 2280 • 2.5" |
| Entrées / Sorties | 2 HDMI 3 USB 3 • 3 USB 2 1 RS232 2 RJ45 1 mic-in / Line Out 1 DC Phoenix |
| Alimentation | AC 100~240V, 50Hz/60 Hz, DC 12V/4A Option 9V~36V DC |

| Communication | |
|-------------------|---|
| Ethernet | 2 RJ45 INTEL I225 (2.5 GbE) |
| WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Option) |
| Bluetooth | BT4.2 (Option) |
| 3G/4G (Option) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| RFID (Option) | 13.56 GHz+125 Khz |



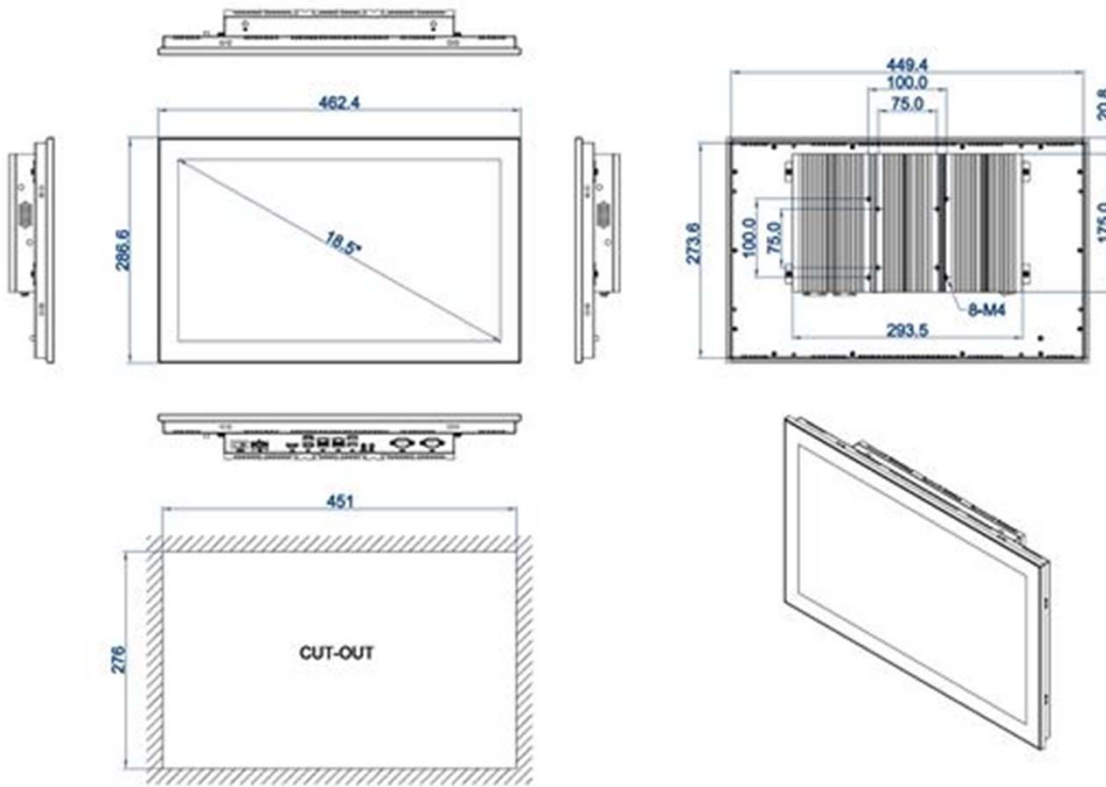
Environnement

| | |
|-----------------|--|
| Temp. fonction. | 0°C ~ 50°C |
| Temp. Stockage | -20°C ~ 60°C |
| Humidité | 10%~90% |
| Durcissement | IP66 face avant Châssis métal + aluminium |

Dimensions / Construction

| | |
|------------|--|
| Matériau | Aluminium / Acier |
| Dimensions | 462 x 296 x 56 mm Découpe: 451 x 276 mm |
| Poids | Environ 5.6 kg |
| Fixation | Encastrement (joint + vis) VESA 75 / 100 |

Dimensions



Options / Accessoires



Dalle résistive



Module 4G



Module Wifi



Fixation VESA

12-24V



12~24V DC